

T/CPCA 4105-2016 《印制电路用金属基覆铜箔层压板》

团体标准第一号修改单

一、第1章 范围

“本标准规定了印制电路用金属基覆铜箔层压板的分类、材料、要求、质量保证、包装、标志、运输及贮存。”

替换为以下语句：

“本文件规定了印制电路用金属基覆铜箔层压板的分类、材料、要求、试验方法、质量保证、包装、标志、运输及贮存、订单资料。”

二、第2章 规范性引用文件

“GB/T 2040 铜及铜合金带材
GB/T 2521 冷轧取向和无取向电工钢带（片）
GB/T 3880（所有部分） 一般工业用铝及铝合金板、带材
GB/T 4722 印制电路用覆铜箔层压板试验方法
GB/T 5230 印制电路用铜箔”

替换为以下语句：

“GB/T 2040 铜及铜合金板材
GB/T 2521（所有部分） 全工艺冷轧电工钢
GB/T 3198 铝及铝合金箔
GB/T 3880（所有部分） 一般工业用铝及铝合金板、带材
GB/T 4722 印制电路用刚性覆铜箔层压板试验方法
GB/T 5230 印制板用电解铜箔”

三、第5章 结构和材料

5.2.2 金属板中的“铝板应符合 GB/T 3880 各部分的规定；铜板应符合 GB/T 2040 规定或由供需双方商定；铁板应符合 GB/T 2521 规定或由供需双方商定；”

替换为以下语句：

“铝板应符合 GB/T 3198 或 GB/T 3880 各部分的规定；铜板应符合 GB/T 2040 规定或由供需双方商定；铁板(钢板)应符合 GB/T 2521 各部分的规定或由供需双方商定；”

四、第 6 章 要求

表 7 替换为:

表7 绝缘粘结层标称厚度及公差

单位为毫米

标称厚度 (t_1)	公差	
	1级	2级
$t_1 < 0.075$	由供需双方商定	
$0.075 \leq t_1 < 0.120$	± 0.018	± 0.013
$0.120 \leq t_1 < 0.165$	± 0.025	± 0.018
$t_1 \geq 0.165$	由供需双方商定	

将表 9、表 10、表 11 的“7. 介电常数（接收态）（供选），1 MHz”由“ ≤ 8.0 ”改为“供需双方商定”。

五、附录 B

B. 10. 1. 3. 3 中的“介电常数准确至 0. 1，介质损耗角正切值准确至 0. 001。”

替换为以下语句：

“介电常数保留 1 位小数，介质损耗角正切值保留 3 位小数。”

B. 11. 2 的序号“d) e) f) ”

替换为：

“a) b) c) ”。
